

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-095

北京东土科技股份有限公司

关于投资设立控股子公司的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司战略规划及推动公司智能控制技术在半导体业务的应用，公司投资设立了控股子公司北京东土半导体技术有限公司（以下简称“东土半导体”），现将相关情况公告如下：

一、设立控股子公司的情况概述

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）与北京力途科技有限公司（以下简称“力途科技”）、北京道芯致合信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“道芯致合”）共同投资设立北京东土半导体技术有限公司，注册资本 1,000 万元；其中公司以自有资金认缴出资 750 万元，持股 70%；力途科技认缴出资 50 万元，持股 5%；道芯致合作为东土半导体的员工持股平台认缴出资 250 万元，持股 25%。东土半导体已于近日完成工商注册登记，并已取得北京市石景山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次投资设立控股子公司事项无需提交董事会、股东会审议。本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立控股子公司的基本情况

公司名称：北京东土半导体技术有限公司

统一社会信用代码：91110107MAETBGDD1Q

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 08 月 27 日

法定代表人：李平

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 11 层 904

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；图文设计制作；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
1	北京东土科技股份有限公司	700	70%
2	北京力途科技有限公司	50	5%
3	北京道芯致合信息咨询中心（有限合伙）	250	25%
	合计	1,000	100%

三、设立控股子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

当前，半导体设备领域正处于“自主可控”战略深化落地的关键阶段，《“十四五”智能制造发展规划》等政策明确将半导体设备核心部件国产化列为重点任务，构建本土供应链体系成为保障国家产业安全、推动高端装备制造升级的核心要求。

半导体设备领域是公司智能控制器及解决方案业务打开高端装备制造市场的战略切入点，公司在该领域的业务已取得突破。2024 年以来公司与头部企业

建立深度合作，双方围绕半导体设备工控系统国产化替换展开深度协同，目前已完成数百台定制化智能工业控制设备的交付，产品覆盖半导体刻蚀、清洗等关键设备环节；同时，形成了从底层国产鸿蒙工业操作系统、工业网络、控制器硬件及专用板卡，到上层 MaVIEW 软件的国产化系统级全栈解决方案，完成从产品级到解决方案、工艺控制、策略优化深度应用；标志着公司智能控制技术在半导体领域的业务已从适配验证进入商业化落地阶段。

为进一步激发核心团队积极性、提升半导体设备市场业务拓展效率，公司决定设立北京东土半导体技术有限公司，通过精细运营与市场化激励机制，加速推进半导体设备工控核心技术的迭代升级，扩大商业化交付规模，为公司新兴业务放量奠定基础。

本次投资设立控股子公司事项不会对公司本年度的财务和经营状况产生重大影响、不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次设立控股子公司事项符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性因素，公司管理层将密切关注东土半导体的经营管理等情况，积极采取有效措施防范和降低经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 《北京东土半导体技术有限公司营业执照》

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日